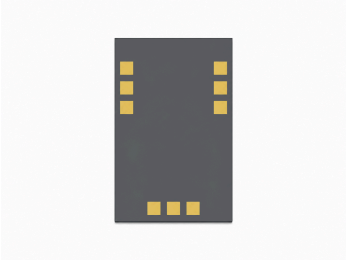
2000–6000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte · TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	-	2000	-	6000	2000–6000	MHz
Isolation	-	-	20	-	-	dB
Eingangs-VSWR	-	-	1.3	-	-	-
Ausgangs-VSWR	-	-	1.2	-	-	-

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	30	dBm

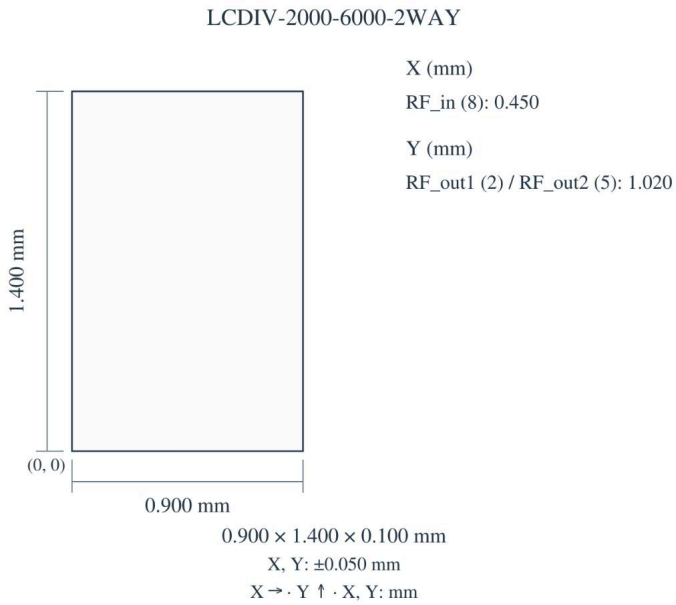
Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	0.9 × 1.4 × 0.1	mm

Mechanische Maßzeichnung



Alle Maße in mm [in].

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Masse; kein Bonddraht erforderlich	-
2	RFout1	RF-Ausgang	1
5	RFout2	RF-Ausgang	2
8	RFin	RF-Eingang	-

Aktueller Publikationsstand · 1.3 · 2026-10-27. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.2.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

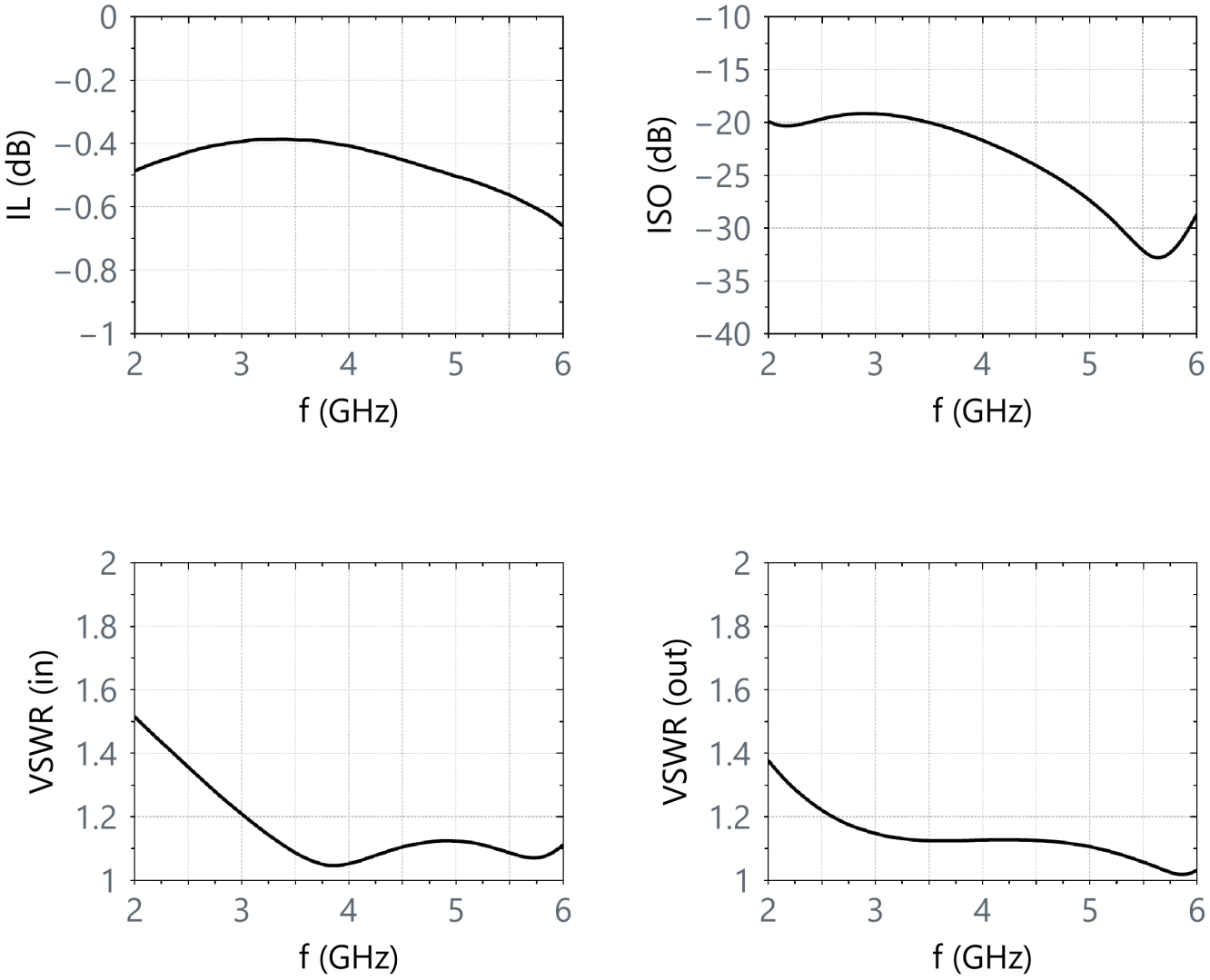
Maßskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Einfügedämpfung; Isolation; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung.

Die dargestellten Original-Diagrammflächen samt Kurven und Raster bleiben erhalten; nur äußere Achsen und Anordnung sind neu gesetzt. Messdatenreihen oder verdeckte Zustände werden nicht rekonstruiert.



Quelle

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.